

2023.08.02 新产品发布

## 本公司开始销售实现生产率加倍<sup>(※1)</sup>的 半导体封装用“焊锡球植球设备N系列”的通知

艾美柯技术株式会社 (AIMECHATEC, Ltd., 总部: 日本茨城县龙崎市向阳台, 社长: 阿部猪佐雄), 作为半导体封装事业的新提案, 将开始销售新产品“半导体封装用焊锡球植球设备N系列”。

本公司, 作为尖端半导体封装用G系列产品的后续, 以标准半导体封装市场为对象而开发了该设备, 将通过多年来培养的植球技术与本公司的开发能力和制造能力相结合, 在低成本的要求下实现了加一倍<sup>(※1)</sup>的面积生产率, 还标准配备了Dark Ball检查功能。我们将以现有G系列加上新N系列产品, 进行全面覆盖半导体封装市场的提案。

随着5G、物联网和人工智能等市场的成长, 对优越于生产率, 成本以及环境的焊锡球植球法的需求正在发展。尤其在标准半导体封装市场上, 对低成本和提升面积生产率的需求也在增长, 于是本公司提供一站式解决助焊剂印刷, 植球, 检查, 修补工序的新N系列产品的方案。

我们已经在海外的展览会上, 对半导体客户开始了介绍, 也有进行具体项目的谈判。我们将晶片用设备和封装基板用设备同时开售, 预计年销量二十条线以上。

本公司依旧本着通过制程工艺上的不断创新, 以达到创造更方便更丰富的生活方式, 为社会做出更多的贡献而努力。

※1) 面积生产率: 对设置面积的产量, 数据为与本公司现有产品相比

咨询: 艾美柯技术株式会社  
营业部 TEL: 0297-62-9119  
<https://www.ai-mech.com>



新产品 焊锡球植球系统, N系列 (外观)